

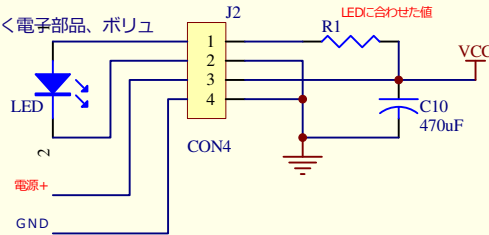
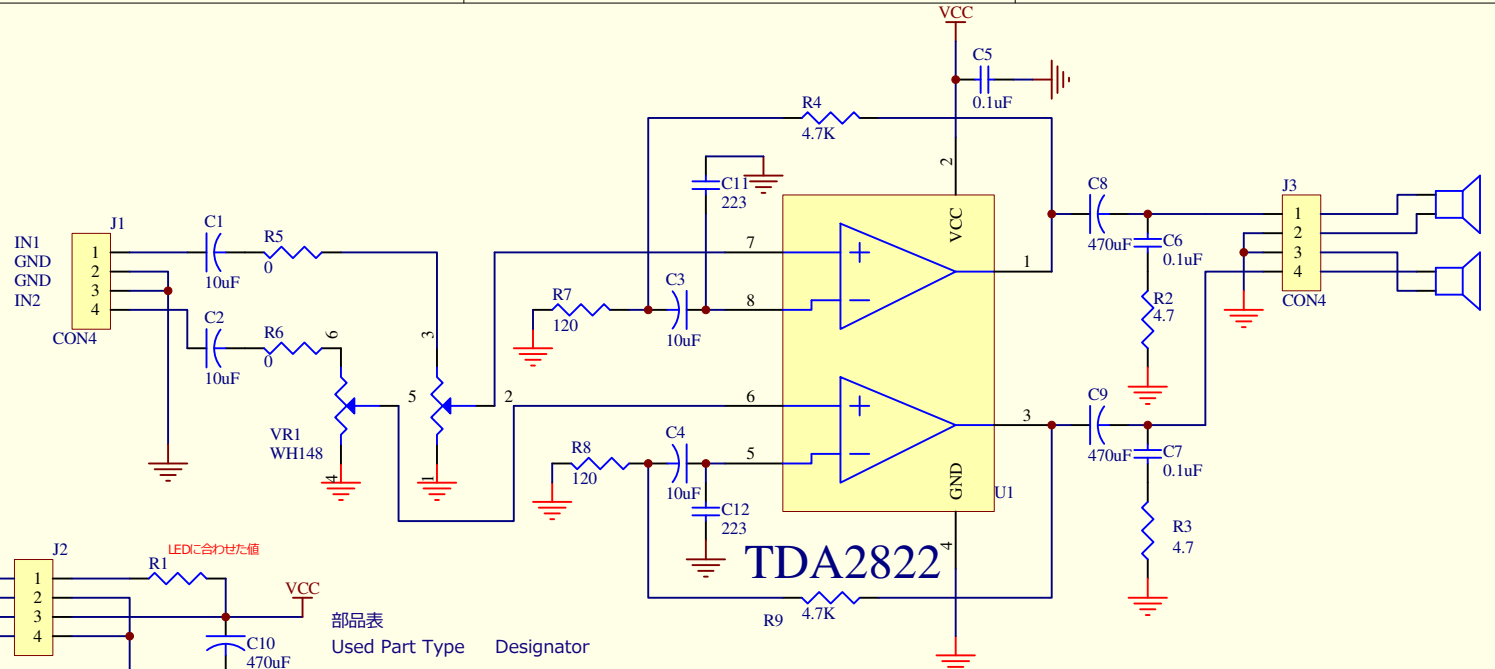
作り方

基板に部品実装する順番は高さの低いICから半田付けしていきます。
コンデンサーには極性があります。実装時確認してください。
ボリュームは一番最後に実装し、1ピンだけを借り半田し、直角平行を確認後半田付けします。

(基板がスルーホールなので付け直しには工具が必要です。)
J2の1ピンはパイロットLEDの出力です。電源電圧とLEDに合わせた抵抗をお使いください。
R5,6は切り取ったリードをお使いください。
ICのデータシート通りに組立てたい方は左下の回路をご利用ください。
2台作って聴き比べもよいと思います。
また、本基板の電源定格は3~9Vを推奨します。車載用に使う場合は必ずヒューズ等入れてください。

特性を追求する場合、入力カップリングコンデンサーをマイラにしたり出力カップリングコンデンサー等の容量を変える、IC入力にコンデンサーを入れて、周波数のフラット化など、魔改造してみてください。
但し、ICの定格を超えてご使用の場合、ICが壊れる可能性があります。自己責任で改造改造してください。

今回は、生基板+TDA2822、生基板+ボリュームを除く電子部品、ボリュームを含む基板キットの3構成をご用意する予定です。

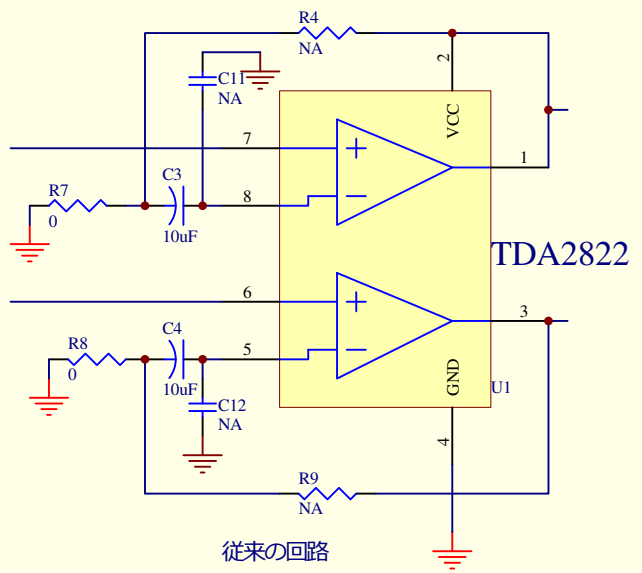


部品表

Used	Part Type	Designator
3	104	C5 C6 C7
3	4.7	R2 R3
2	4.7K	R4 R9
1	NA	R1
2	10uF	C1 C2
2	10uF	C3 C4
2	120	R7 R8
3	470uF	C8 C9 C10
2	223	C11 C12
3	CON4	J1 J2 J3
3	0	R5 R6
1	TDA2822	U1
1	WH148 (10K)	VR1

電圧利得低減回路 (ホワイトノイズ小)

アンプのゲインを下げ無音時のノイズを低減します。
従来本アンプゲインは40dB以上あるが、それを30dB以下にすることでホワイトノイズが大幅に減少する事が可能です。
さらにヘッドフォンなど利用したい場合、R5,R6に適切な抵抗を入れてください。
それでもヘッドフォンでのノイズが気になる場合、ヘッドフォンとの間にアッテネータ回路を組むのがよいです。アッテネータ回路で減衰とインピーダンスマッチングすれば理想的です。
アッテネータを組む場合、1W程度の抵抗が必要です。



従来回路

低ノイズ 2822ステレオミニアンプ
BeansAmp ST V1.1

合資会社エフエーエル	Size	FCSM No.	DWG No.	Rev
	A4			
Scale			Sheet	0 of 0